



PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD PODPREDESEDU VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE PLÁN OBNOVY
A ZNALOSTNÚ EKONOMIKU



MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



DODATOK č. 2

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTŘEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Č. 311/2023-2060-4231-00002

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „**Dodatok**“)

medzi

Vykonávateľ:

Názov: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku
Sídlo: Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava
IČO: 56 565 321
(ďalej ako „Úrad podpredsedu vlády SR“)

v zastúpení:

Názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
IČO: 00 686 832
Konajúca osoba: PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ sekcie európskych programov, v zmysle
Podpisového poriadku Ministerstva hospodárstva SR

(ďalej ako „Sprostredkovateľ“)

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh Vykonávateľa
Sprostredkovateľom pre komponent 9 Plánu obnovy: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania
výskumu, vývoja a inovácií uzatvorenej pod č. 862/2022, reg. č. MH SR: 217/2022-2060-4250

(ďalej ako „**Vykonávateľ**“)

a

Prijímateľ:

Názov: Continium Technologies s.r.o.
Sídlo: Moyzesova 1038/24, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 53 614 836
Konajúca osoba: Ing. Jozef Bujnovský, konateľ
Poštová adresa: Ing. Jozef Bujnovský, Záleská 19/A, 90028 Ivanka pri Dunaji

(ďalej ako „**Prijímateľ**“)

(**Vykonávateľ** a **Prijímateľ** sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti označujú ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ a každý z nich jednotlivo len ako „**zmluvná strana**“)

PREAMBULA

- (A) **Zmluvné strany** uzatvorili dňa 29.11.2023 **Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti** pod č. 311/2023-2060-4231-00002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.11.2024 (ďalej ako „**Zmluva**“). Predmetom **Zmluvy** je spolufinancovanie Prijímateľom realizovaného projektu s názvom: Development of a chip-integrated wireless receiver for 5G/6G base stations

(BTS)based on high-frequency digitalization of broad-band, lowest-power A/D-Converters, kód Projektu: 09I05-03-V01-00002 (ďalej ako „**Projekt**“.)

- (B) Na základe § 40ay zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 201/2024 Z. z. došlo k formálnej zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene v subjekte Vykonávateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu v súlade s čl. 10 ods. 3 písm. a) VZP z pôvodného Úradu vlády Slovenskej republiky - Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
- (C) Zmluvné strany sa v zmysle článku 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ ods. 7.2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku v článku I. Zmluvné strany sa dohodli aj na ďalších súvisiacich úpravách svojho zmluvného vzťahu uvedených v článku II. a III. tohto Dodatku.

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že text Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa týmto Dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:
 - 1.1 Na titulnej strane Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa označenie Vykonávateľa nahrádza a znie nasledovne:

„Názov: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku
 Sídlo: Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava
 IČO: 56 565 321
 (ďalej ako „Úrad podpredsedu vlády SR“)“.
 - 1.2 V článku 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“ ods. 1.2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa prvá veta dopĺňa a znie nasledovne:

„Pojmy použité v tejto **Zmluve** sú definované v **Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, vo **VZP**, v **Právnom rámci** a/alebo v **Závaznej dokumentácii**. **Zmluvu** je potrebné vykladať so zreteľom a v nadväznosti na **Právny rámec**, **Výzvu** a **Závaznú dokumentáciu**.“
 - 1.3 V článku 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“ ods. 1.4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa text: „Úradu vlády SR“ nahrádza textom: „Úradu podpredsedu vlády SR“.
 - 1.4 Do článku 3 „VÝDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU“ Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa vkladá nový ods. 3.9, ktorý znie:

„3.9 **Prijímateľ** sa zaväzuje, že poskytnutím alebo použitím **Prostriedkov mechanizmu** nedôjde k porušeniu reštriktívnych opatrení alebo sankcií EÚ, k porušeniu iných sankcií alebo obdobných opatrení, k dodržiavaniu ktorých sa SR zaviazala, ani k porušeniu zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.“
 - 1.5 V článku 6 „ĎALŠIE ZÁVÄZNÉ DOJEDNANIA“ Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa ods. 6.5 nahrádza nasledovným znením:

„6.5 **Prijímateľ** berie na vedomie, že realizácia **Predmetu Projektu** prebieha v súlade so **Zmluvou** a s **Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu** prostredníctvom realizácie výskumno-vývojovo-inovačnej fázy a fázy prvého priemyselného nasadenia, alebo jej časti (ak relevantné).
Prijímateľ je povinný a zároveň sa zaväzuje:

 - a) riadne ukončiť realizáciu **IPCEI projektu** v súlade s **Dokumentáciou notifikovaného projektu**, s výnimkou prípadu podľa ods. 6.14 tohto článku,
 - b) splniť všetky povinnosti a dodržať všetky podmienky podľa Prílohy č. 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** a zároveň splniť všetky povinnosti a dodržať všetky podmienky **IPCEI projektu** vyplývajúce z **Dokumentácie notifikovaného projektu**, z **IPCEI nariadenia**, ako aj z **Rozhodnutia EK o pomoci**, s výnimkou prípadu podľa ods. 6.14 tohto článku, čím nie je dotknutá povinnosť **Prijímateľa** podľa čl. 2 ods. 2.5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**,

- c) v súlade s **Výzvou** najneskôr k **Ukončeniu vecnej realizácie Projektu** dosiahnuť **výstupy Projektu (Deliverables)** podľa Prílohy č. 3 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** vychádzajúce z **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu** a vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie **míľnikov (milestones) Projektu**,
- d) zabezpečiť riadnu realizáciu **IPCEI projektu** v súlade so **Zmluvou** tak, aby **Výstupy a ciele IPCEI projektu** mohli byť dosiahnuté najneskôr do doby, do ktorej bude **Prijímateľ** povinný riadne ukončiť realizáciu **Druhej fázy IPCEI projektu**,
- e) počas **Realizácie Projektu** zniesť výkon **priebežného (midterm) hodnotenia** zabezpečeného **Vykonávateľom**. Priebežné (midterm) hodnotenie bude zamerané na posúdenie dosahovania **míľnikov (milestones)** a **výstupov Projektu (Deliverables)** v súlade s **Výzvou** tak, aby **Výstupy a ciele IPCEI projektu** boli (mohli byť) dosiahnuté najneskôr do ukončenia realizácie **IPCEI projektu** (relevantné v prípade, ak v čase výkonu priebežného (midterm) hodnotenia **Prijímateľovi** vznikol nárok na spolufinancovanie **Druhej fázy IPCEI projektu** z verejných zdrojov). Predmetom priebežného (midterm) hodnotenia môže byť aj posúdenie plnenia povinností a podmienok vyplývajúcich z **Dokumentácie notifikovaného projektu**, z **Rozhodnutia EK o pomoci**, ako aj z Prílohy č. 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. Zároveň je **Prijímateľ** povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** všetku potrebnú súčinnosť pri výkone tohto hodnotenia a v súvislosti s ním. **Prijímateľ** sa tiež zaväzuje prijať opatrenia v súlade s výsledkami/odporúčaniami tohto **priebežného (midterm) hodnotenia**, informovať o nich **Vykonávateľa** a s ich zohľadnením zabezpečiť Riadnu **Realizáciu Projektu** a dosiahnutie **Cieľa Projektu**.

Porušenie akejkoľvek povinnosti podľa tohto odseku 6.5 predstavuje podstatné porušenie **Zmluvy** zo strany **Prijímateľa** a oprávňuje **Vykonávateľa** na mimoriadne ukončenie **Zmluvy** v zmysle čl. 11 **VZP**.

Plnenie povinností **Prijímateľa** podľa relevantných ustanovení článku 6 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** vyhodnocuje **Vykonávateľ** na základe:

- i) informácií vyplývajúcich z **Reportingu**,
- ii) správ a informácií, ktoré je podľa článku 5 odsek 8 **VZP Prijímateľ** povinný **Vykonávateľovi** na požiadanie poskytnúť,
- iii) priebežného (midterm) a/alebo záverečného hodnotenia **Realizácie Projektu** a/alebo
- iv) odborného stanoviska **Vykonávateľom** vybraného experta.“.

- 1.6 V článku 6 „ĎALŠIE ZÁVÄZNÉ DOJEDNANIA“ ods. 6.6. **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** sa text „odseku 6.5 ods. 6.5 i) až iv)“ nahrádza textom „odseku 6.5 bodov i) až iv)“.
- 1.7 V článku 6 „ĎALŠIE ZÁVÄZNÉ DOJEDNANIA“ **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** sa ods. 6.8 nahrádza nasledovným znením:
 „6.8 Po **Ukončení vecnej realizácie Projektu** sa **Prijímateľ** zaväzuje zniesť výkon záverečného hodnotenia zabezpečeného **Vykonávateľom**. Záverečné hodnotenie bude zamerané na posúdenie dosiahnutia **míľnikov (milestones)** a **výstupov Projektu (Deliverables)** v súlade s **Výzvou** za účelom posúdenia skutočností, či **Výstupy a ciele IPCEI projektu** môžu byť dosiahnuté najneskôr do doby, do ktorej je/bude **Prijímateľ** povinný riadne ukončiť **IPCEI projekt** (relevantné v prípade, ak v čase výkonu záverečného hodnotenia **Prijímateľovi** vznikol nárok na spolufinancovanie **Druhej fázy IPCEI projektu** z verejných zdrojov). Predmetom záverečného hodnotenia môže byť aj posúdenie plnenia povinností a podmienok vyplývajúcich z **Dokumentácie notifikovaného projektu**, z **Rozhodnutia EK o pomoci**, ako aj z Prílohy č. 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. Zároveň je **Prijímateľ** povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** všetku súčinnosť pri výkone tohto hodnotenia a v súvislosti s ním.“.
- 1.8 V článku 6 „ĎALŠIE ZÁVÄZNÉ DOJEDNANIA“ ods. 6.9. **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** sa v prvej vete text „fázu prvého priemyselného nasadenia **IPCEI Projektu**“ nahrádza textom „**Druhá fáza IPCEI Projektu**“.
- 1.9 V článku 6 „ĎALŠIE ZÁVÄZNÉ DOJEDNANIA“ ods. 6.12. **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** sa na konci vety vypúšťa text „**IPCEI projektom a**“.
- 1.10 V článku 6 „ĎALŠIE ZÁVÄZNÉ DOJEDNANIA“ **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** sa za ods. 6.12. vkladajú nové ods. 6.13. až 6.15., ktoré znejú nasledovne:

- „6.13. **Prijímatel'** sa zaväzuje po ukončení realizácie **Prvej fázy IPCEI projektu** zrealizovať **Druhú fázu IPCEI projektu**. V tejto súvislosti po vyhlásení príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z verejných zdrojov alebo iného obdobného dokumentu je **Prijímatel'** povinný predložiť žiadosť o poskytnutie zdrojov na spolufinancovanie **Druhej fázy IPCEI projektu** alebo vykonať iný obdobný úkon do uzavretia takejto výzvy. **Prijímatel'** sa zaväzuje vykonať všetky potrebné úkony s odbornou starostlivosťou tak, aby splnil podmienky pre získanie podpory a pre vznik nároku na spolufinancovanie **Druhej fázy IPCEI projektu** z verejných zdrojov.
- 6.14. **Prijímatel'** nie je povinný zrealizovať **Druhú fázu IPCEI projektu** iba v prípade, ak mu do šiestich mesiacov od **Ukončenia realizácie Projektu** nevznikol nárok na spolufinancovanie **Druhej fázy IPCEI projektu** z verejných zdrojov. Za moment vzniku nároku na spolufinancovanie **Druhej fázy IPCEI projektu** z verejných zdrojov podľa predchádzajúcej vety sa považuje nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, právoplatnosť rozhodnutia o schválení žiadostí alebo akýkoľvek iný obdobný úkon potvrdzujúci vznik takéhoto nároku **Prijímateľa**.
- 6.15. **Prijímatel'** je povinný informovať **Vykonávateľa** o skutočnosti, že:
- a) mu vznikol nárok na spolufinancovanie **Druhej fázy IPCEI projektu** Bezodkladne od vzniku takéhoto nároku,
 - b) mu nevznikol nárok na spolufinancovanie **Druhej fázy IPCEI projektu** najneskôr do 15 dní od uplynutia šiestich mesiacov po **Ukončení realizácie Projektu**.“.
- 1.11 V článku 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ ods. 7.1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa text poslednej vety nahrádza nasledovným znením:
„Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov **zmluvné strany** vyhlasujú, že **Zmluva** neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobode informácií.“.
- 1.12 V článku 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ ods. 7.3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa prvá veta textu mení, dopĺňa a znie nasledovne:
„Táto **Zmluva** sa uzatvára na dobu určitú a jej účinnosť končí riadnym ukončením **IPCEI projektu** v súlade s Rozhodnutím EK o pomoci, s výnimkou prípadu podľa čl. 6 ods. 6.14 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, kedy účinnosť **Zmluvy** končí uplynutím lehoty uvedenej v čl. 6 ods. 6.14 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**“.
2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že text Všeobecných zmluvných podmienok ako Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej ako „VZP“) sa týmto Dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:
- 2.1 V článku 1 „VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“ ods. 2 VZP v definícii pojmu „**Deliverables** alebo **Výstupy Projektu**“ v druhej vete sa text „článku 6.9 Zmluvy“ nahrádza textom „článku 6 ods. 6.9 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu“.
- 2.2 V článku 1 „VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“ ods. 2 VZP sa dopĺňajú definície nových pojmov „**Druhá fáza IPCEI Projektu**“ a „**Prvá fáza IPCEI projektu**“ v znení nasledovne:
„**Druhá fáza IPCEI projektu** – časť IPCEI projektu, na ktorú sa nevzťahuje Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu a ktorej realizácia nasleduje po Ukončení realizácie Projektu, t.j. Prvej fázy IPCEI projektu pri zohľadnení ustanovenia čl. 6 ods. 6.14 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu;“;

„**Prvá fáza IPCEI projektu** – časť IPCEI projektu podporená z Prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti v zmysle Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorej obsahujú náplň pre účely tejto Zmluvy predstavuje Projekt, t.j. Realizácia Projektu;“.
- 2.3 V článku 1 „VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“ ods. 2 VZP sa mení definícia pojmu „**IPCEI projekt**“ a znie nasledovne:
„**IPCEI projekt** – projekt, resp. jeho časť, ktorý je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI), v rámci ktorého bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou

notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla (Rozhodnutím EK o pomoci). IPCEI projekt sa pre účely tejto Zmluvy skladá z Prvej fázy IPCEI projektu a Druhej fázy IPCEI projektu. Pre účely tejto Zmluvy z obsahového hľadiska zahŕňa realizáciu výskumno-vývojovo-inovačnej fázy a fázy prvého priemyselného nasadenia (ak relevantné);“.

- 2.4 V článku 1 „VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“ ods. 2 VZP sa v definícii pojmu „Právny rámec“ v písm. a) bod i. nahrádza textom:
„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (pre účely tejto Zmluvy len „**nariadenie o rozpočtových pravidlách**“);“.
- 2.5 V článku 1 „VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“ ods. 2 VZP sa v definícii pojmu „Právny rámec“ v písm. a) bod v. nahrádza textom:
„Vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (ST10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (pre účely tejto Zmluvy len „**Vykonávacie rozhodnutie Rady**“);“.
- 2.6 V článku 1 „VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“ ods. 2 VZP sa v definícii pojmu „Rozhodnutie EK o pomoci“ text „implementácie vodíkových technológií“ nahrádza textom „mikroelektroniky“.
- 2.7 V článku 7 „VLASTNÍCVO A POUŽITIE VÝSTUPOV“ ods. 1 písm. b) bod v. časť A VZP sa text „minimálne do ukončenia realizácie fázy prvého priemyselného nasadenia IPCEI projektu“ nahrádza textom „minimálne do ukončenia realizácie fázy prvého priemyselného nasadenia IPCEI projektu okrem prípadu podľa čl. 6 odsek 6.14 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu“.
- 2.8 V článku 7 „VLASTNÍCVO A POUŽITIE VÝSTUPOV“ ods. 1 písm. b) bod v. časť C VZP sa text „aby mohol Realizovať Projekt, ako aj IPCEI projekt“ nahrádza textom „aby mohol Realizovať Projekt, ako aj IPCEI projekt (okrem prípadu podľa čl. 6 odsek 6.14 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu)“.
- 2.9 V článku 7 „VLASTNÍCVO A POUŽITIE VÝSTUPOV“ ods. 2 VZP sa text „až do Ukončenia realizácie fázy prvého priemyselného nasadenia IPCEI projektu:“ nahrádza textom „až do Ukončenia realizácie fázy prvého priemyselného nasadenia IPCEI projektu, resp. v prípade podľa čl. 6 odsek 6.14 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu až do uplynutia tam uvedenej lehoty:“.
- 2.10 V článku 9 „REALIZÁCIA PROJEKTU“ ods. 5 písm. l) VZP sa vypúšťa text „i) až iv)“.
- 2.11 V článku 9 „REALIZÁCIA PROJEKTU“ ods. 10 písm. d) VZP sa vypúšťa text „i) až iv)“.
- 2.12 V článku 11 „UKONČENIE ZMLUVY“ ods. 7 písm. r) VZP sa text „vyplývajúcej“ nahrádza textom „vyplývajúcej“.
- 2.13 V článku 11 „UKONČENIE ZMLUVY“ ods. 7 sa za písm. r) VZP vkladá nové písmeno s), ktoré znie nasledovne:
„Realizácia Projektu spôsobom ohrozujúcim dosiahnutie Výstupov a cieľov IPCEI projektu najneskôr do doby, do ktorej je/bude Prijímateľ povinný ukončiť realizáciu Druhej fázy IPCEI projektu, prípadne majúcim za následok ich nedosiahnutie,“.
- Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno t).
3. Príloha č. 3 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľnú súčasť.
4. Príloha č. 4 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľnú súčasť

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšom znení.
2. Na pojmy, skratky a definície použité v tomto Dodatku sa vzťahujú ustanovenia a výkladové pravidlá uvedené v Zmluve, pokiaľ z článku I. tohto Dodatku nevyplýva inak.
3. Právne účinky zmien uvedených v článku I. tohto Dodatku sa riadia článkom 10 „ZMENA ZMLUVY“ ods. 8 Prílohy č. 1 k Zmluve - VZP. Ustanovenie článku čl. 10 „ZMENA ZMLUVY“ ods. 12 VZP tým nie je dotknuté.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento Dodatok je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobode informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho povinného zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobode informácií, v dôsledku čoho vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Vykonávateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade s článkom 5 Zmluvy. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 2 pre Vykonávateľa. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o dôveryhodných službách“). V prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach Zmluvných strán, ak nie je použitá kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách.
3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, text Dodatku si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, Dodatok neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tomto Dodatku.

Prílohy:

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| Príloha č. 1 | Výstupy Projektu (Deliverables) |
| Príloha č. 2 | Podrobný rozpočet projektu |

.....
Vykonávateľ

v zastúpení

PhDr. Boris Huslica

generálny riaditeľ sekcie európskych programov

.....
Prijímateľ

v zastúpení

Ing. Jozef Bujnovský

konateľ

Dodatok podpísaný elektronicky podľa zákona o dôveryhodných službách.

Výstupy (deliverables) projektu:				
por.č.	názov výstupu:	typ/druh výstupu:	stručný popis výstupu:	obdobie (v mesiacoch) od začiatku realizácie projektu potrebné pre dosiahnutie výstupu:
1.	Proof of massive parallel chip integration of ADC-based wireless receivers with >200MHz bandwidth in cheap 28-20nm technology	Chip design completed: MPW 2. Prototype to be fabricated in 28-20nm technology	Technical locks: Broadband counteracts low power ADC, thus novel ADC architecture needs to be evaluated, multichannel integration challenge Technical challenge to solve the technical locks: Expertise in broadband Sigma-Delta systems and design of multi-path broadband amplifiers, novel DAC in SigmaDelta Feedback, adaptive calibration	31
2.	Proof of massive-parallel single-chip integration of multi-channel ADC wireless MIMO SDR receiver	Multichannel chip design completed: MPW 2. Prototype to be fabricated in 180-130nm technology	Technical challenge to solve the technical locks: Investigation of ultralow-power (μ W) design techniques on lowest possible chip area for interfacing neuromorphic systems. Chip prototype ready to co-nitegrate neuromorphic devices from Bizzcom.	31



PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

Názov výdavku	Kategória výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
a) Feasibility studies, costs of obtaining the permissions required						Nákladová skupina podľa štruktúry Funding gapu
Feasibility study & chip tech selection	f) výdavky na štúdie uskutočniteľnosti vrátane prípravných technických štúdií a výdavky na získanie povolení potrebných na realizáciu projektu	projekt	1	3 189,12	3 189,12	Prípravná štúdia uskutočniteľnosti k výberu polovodičovej implementačnej technológie, cenové a technické porovnanie technológií. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B29 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavok je plánovaný na rok 2024 a 2025.
b) Costs of instruments / equipment						Nákladová skupina podľa štruktúry Funding gapu
Computation/Simulation Server incl. A/C	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	projekt	1	29 811,60	29 811,60	Výdavky spojené s nákupom a inštaláciou dátovej a CAD farmy severov s príslušenstvom (e.g. denná archivácia) a potrebným chladením. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B31 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024 a 2025.
Workstations/Laptops incl basic SW	c) výdavky na iný materiál, dodávky a podobné produkty potrebné na projekt	projekt	1	59 623,20	59 623,20	Výdavky spojené s obstaraním technickej výpočtovej výbavy pre personál v podobe hardwaru a softwaru e.g. laptop, monitor, tablet, MS Office balík vrátane Teams licencií, klávesnica, Wifi/5G stick, mobilný telefón, slúchadlá/headset, antivírusový program etc. a iné. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B32 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024 a 2025.
d) Costs of materials / supplies						Nákladová skupina podľa štruktúry Funding gapu
MPW prototyping cost (10mm ²) in 28-22-20nm	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	projekt	1	173 273,00	173 273,00	Výdavky spojené s výrobou polovodičových čipových prototypov (výroba masiek, výroba waferov, skladovanie masiek & waferov, rôzne výrobné hold-on opcie, transport), vo vybranej polovodičovej technológii e.g. s minimálnou tranzistorovou veľkosťou 28-22-20 nanometrov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B40 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024, 2025 a 2026
MPW/MLM prototyping cost (10mm ²) in 130-180-350nm	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	projekt	1	86 322,50	86 322,50	Výdavky spojené s výrobou polovodičových čipových prototypov (výroba masiek, výroba waferov, skladovanie masiek & waferov, rozne výrobné hold-on opcie, transport), vo vybranej polovodičovej technológii napr. s minimálnou tranzistorovou veľkosťou 130-180-350 nanometrov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B44 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024 2025 a 2026
Prototype Packaging	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	projekt	1	93 161,25	93 161,25	Výdavky spojené so zákazkovým vývojom puzdier, výrobou sady čipových puzdier pre vyvinuté polovodičové prototypy ako i samotným zapuzdrením (assembly, rezanie waferov) vyrobených čipových prototypov pomocou drátového bondingu alebo flip-chip kontaktných guľčiek. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B46 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024, 2025 a 2026
Evaluation Board including FPGA	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	projekt	1	105 882,13	105 882,13	Výdavky spojené s vývojom (HW & SW) a výrobou na mieru vyhotovenej sady meracích alebo testovacích dosiek slúžiacich na evaluáciu a testovanie u zákazníka alebo v laboratóriu, vrátane nákupu elektronických a mechanických súčiastok a ich osadenie na doskách. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B47 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024, 2025 a 2026
Chip sockets	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	projekt	1	62 107,50	62 107,50	Výdavky spojené s nákupom čipových soketov/pátic alebo iného mechanického upevnenia pre testovanie a meranie polovodičových čipov na elektronickej doske. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B48 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavok je plánovaný na rok 2024, 2025 a 2026

CAD licencie TANNER	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	projekt	1	48 000,00	48 000,00	Ide hlavne o nasledovné licencie: CAD Licence Tanner (Purchase): Výdavky spojené s nákupom alebo leasingom sady licencií CAD programov na návrh a simuláciu elektronických obvodov, v ktorej sa vyvíjajú polovodičové čipy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B50 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024 a 2025. CAD Maintenance Tanner (Annually): Výdavky za ročný aktualizčný a správčovský poplatok za CAD licenciu, v ktorej sa vyvíjajú polovodičové čipy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B51 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024 a 2025, 2026 A iné
Licencie k CAD softvéru na vývoj a simuláciu	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	projekt	1	744 047,85	744 047,85	Ide hlavne o nasledovné licencie: CAD Simulator Licence Cadence/Synopsys/Mentor (Lease): Výdavky spojené s nákupom alebo leasingom sady licencií CAD programov na návrh a simuláciu elektronických obvodov, v ktorej sa vyvíjajú polovodičové čipy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B52 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na roky 2024, 2025 a 2026 CAD Layout Editor Licence (Purchase) (Juspertor): Nákup CAD programových licencií, v ktorých sa vyvíjajú a navrhujú polovodičové čipy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B53 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavok je plánovaný na rok 2024, 2025 a 2026 CAD Layout Licence Cadence/Synopsys/Mentor (Lease): Výdavky spojené s nákupom alebo leasingom sady licencií CAD programov na návrh a verifikáciu fyzikálnych masiek polovodičových čipov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B54 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na roky 2024, 2025 a 2026 CAD Cadence/Synopsys/Mentor other licences (Lease): Výdavky spojené s nákupom alebo leasing CAD programovej licencie, v ktorej sa vytvárajú návrhy čipov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B55 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavok je plánovaný na roky 2024, 2025 a 2026.
Remote working cooperation platform	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	projekt	1	27 327,30	27 327,30	Výdavky spojené s nastavením a údržbou siete výpočtovej techniky prepojenej so serverom, údržba licencií alebo inštalácia nových programov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B58 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024 a 2025.
e) Costs for patents / intangible assets / contractual research						Nákladová skupina podľa štruktúry Funding gapu
Digital HDL design&FPGA implementation of postprocessing	c) výdavky na iný materiál, dodávky a podobné produkty potrebné na projekt	projekt	1	55 589,49	55 589,49	Výdavky spojené s obstaraním digitálneho HDL dizajnu a jej následnej implementácie v FPGA podľa špecifikácie CTSD systému. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B64 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024 a 2025.
Design of evaluation board	c) výdavky na iný materiál, dodávky a podobné produkty potrebné na projekt	projekt	1	28 357,20	28 357,20	Výdavky spojené vývojom (HW & SW) a výrobou na mieru vyhotovenej sady meracích alebo testovacích dosiek slúžiacich na evaluáciu a testovanie u zákazníka alebo v laboratóriu, vrátane nákupu elektronických a mechanických súčiastok a ich osadenie na doskách. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B65 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024 a 2025.
Contractual research with ind. partners	c) výdavky na iný materiál, dodávky a podobné produkty potrebné na projekt	projekt	1	185 298,30	185 298,30	Výdavky spojené s obstaraním podporných vedeckých služieb. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B67 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024 a 2025.
f) Personnel / administrative costs including overheads						Nákladová skupina podľa štruktúry Funding gapu
f.1) Employees						Personál, ktorý sa plánuje zamestnať na trvalý pracovný pomer.
Personálne výdavky	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	projekt	1	1 655 128,33	1 655 128,33	Výdavky za prácu personálu pracujúceho na 18 pracovných pozíciách na základe pracovného pomeru alebo dôhod mimo pracovného pomeru za obdobie realizácie projektu kumulatívne (popis činností a kompetencií vykonávaných v rámci realizácie projektu je popísaný v personálnej matici projektu).

f2) Freelancers						Personál, ktorý sa neplánuje zamestnať na trvalý pracovný pomer napríklad z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov alebo krátenia projektového rozpočtu v počiatočnej fáze.
Design Engineers	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	projekt	1	211 656,06	211 656,06	Výdavok za služby "Design Engineers" (technická expertíza v oblasti dizajnu návrhov čipu) poskytované dodávateľsky za obdobie realizácie projektu. Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referenčného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania prúdom: current biasing) a následne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulator) a iteratívne zlepšuje tieto elektronicky obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre nim navrhnuté obvody/bloky a tiež overuje zhoršenie vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a tým zodpoveda za spravnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation
Layout engineer (technik)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	projekt	1	100 000,00	100 000,00	Výdavky spojené s nákupom na mieru vyvinutého a nakresleného layoutu pre špecifické čipové bloky. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B63 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2025 a 2026.
Technical Lead - Layout Engineer	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	projekt	1	275 711,52	275 711,52	Výdavok za služby "Technical Lead - Layout Engineer" (technická expertíza v oblasti návrhu layoutu čipu) poskytované dodávateľsky za obdobie realizácie projektu. Navrhuje fyzikálne masky (physical layout design) pre elektronické obvody a schémy dodané navrharmi (Design engineers) na úrovni jednotlivých blokov (operačné zosilnovace, komparatori, filtre) ale i celého čipového systému v spolupráci s Technical Lead - Design Engineer. Zodpoveda za design checks: DRC (design rule check) a LVS, a za generovanie parazitných R,L,C elementov pomocou CAD software. Zodpoveda za definovanie požiadaviek na instaláciu CAD software a PDK (process development kits) pre návrh layoutu, ako i správne plánovanie personálnych zdrojov a tiež dozera spoluprácu vyvoja návrhom elektronických obvodov so svojim protejškom "Technical Lead -Design Engineer". Zodpoveda za spravnosť a funkčnosť celého systému pred odovzdaním elektronického čipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriová výroba) zo strany fyzikálnych masiek a ich generovania parazitných R,L,C elementov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B72 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation
g) Ostatné poskytované služby/Other services provided						
Design Engineers	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	projekt	1	360 704,97	360 704,97	Výdavok za služby "Design Engineers" (technická expertíza v oblasti dizajnu návrhov čipu) poskytované dodávateľsky za obdobie realizácie projektu. Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referenčného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania prúdom: current biasing) a následne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulator) a iteratívne zlepšuje tieto elektronicky obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre nim navrhnuté obvody/bloky a tiež overuje zhoršenie vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a tým zodpoveda za spravnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation
Public Procurement Specialist	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	projekt	1	161 608,10	161 608,10	Výdavok za služby "Public Procurement Specialist" (oblasť poradenstva pre riadenie procesov verejného obstarávania/obstarávania) poskytované dodávateľsky za obdobie realizácie projektu. Zodpovedný za vykonávanie procesov spojených s verejným obstarávaním. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B75 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation

<i>IPCEI Coordinator</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	projekt	1	148 140,76	148 140,76	Výdavok za služby "IPCEI Coordinator" (oblasť riadenia IPCEI projektu) poskytované dodávateľsky za obdobie realizácie projektu. Zodpovedá za koordináciu komunikácie, reportingu a výkazníctva medzi MH a firmou Continium a zabezpečenie všetkých náležitostí. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B76 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation
<i>Management Accountant</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	projekt	1	250 646,84	250 646,84	Výdavok za služby "Management accountant" (oblasť vedenia a riadenia účtovníctva) poskytované dodávateľsky v období realizácie projektu. Zodpovedný za interné účtovníctvo, reporting a manažment finančných ukazovateľov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B77 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation
<i>Financial Accountant/Biz. Dev</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	projekt	1	673 367,08	673 367,08	Výdavok za služby "Financial Accountant/Biz. Dev." (oblasť finančného riadenia a riadenia rozvoja obchodu) poskytované dodávateľsky za obdobie realizácie projektu. Zodpovedný za finančné plánovanie, tvorbu firemnej stratégie a tvorbu odberateľských kanálov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B78 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation
<i>Technical Project Manager</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	projekt	1	194 997,60	194 997,60	Výdavok za služby "Technical Project Manager" (oblasť technického riadenia projektu) poskytované dodávateľsky za obdobie realizácie projektu. Definuje parametre a architektúru navrhovaného čipu (napr. A/D prevodníka), robí návrh architektúry systému v matematických programoch (Matlab, Python) a optimalizuje jeho parametre (koeficienty spätnej väzby, šírka pásma, sum), definuje pod-bloky a definuje ich parametre (napr. zosilnenie, šírka pásma, maximálny sum a nelineárnosť, maximálna spotreba prúdu) a overuje funkčnosť celého systému na abstraktnej úrovni pomocou behavioural simulation (VerilogA, VerilogAMS, VHDL-AMS) pred jednotlivým návrhom elektronických schém daných podblokov. Zodpovedá za návrh elektronických obvodov, schémy a ich layout (fyzikálny návrh masiek), zodpovedá za správnosť a funkčnosť celého systému/čipu z hľadiska simulácie fyzikálnych parametrov (napr. v CAD software pomocou SPICE simulátora) a tiež za správnosť v návrhu layoutu (napr. pomocou CAD software pre DRC a LVS checks), za funkčnosť celého systému aj s ich reálne generovanými parazitnými R,L,C elementami, pred odovzdaním čipu do produkcie (MPW prototyping alebo sériová výroba). Diskutuje návrh systému so zákazníkmi alebo partnermi v EU projekte, zodpovedá za reporting voči EU/Ministerstvu a píše vedecké publikácie pre konferencie a odborné časopisy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B69 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation
<i>Matlab-Simulink/Python/National Instruments licences</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	projekt	1	52 170,30	52 170,30	Výdavky spojené s nákupom programových licencií na tvorbu matematických programovacích modelov alebo ich simulácií e.g. Matlab, Python etc. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B49 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na roky 2024, 2025 a 2026
<i>IT Infrastructure (network setup&maintenance)</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	projekt	1	39 550,90	39 550,90	Výdavky spojené s nastavením alebo leasingom rozšírenej sady licencií programov na návrh, simuláciu alebo verifikáciu polovodičových čipov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B57 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024 a 2025.

<i>Feasibility study & chip tech selection</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	projekt	1	30 000,00	30 000,00	Prípravná štúdia uskutočniteľnosti k výberu polovodičovej implementačnej technológie, cenové a technické porovnanie technológií. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B29 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavok je plánovaný na rok 2024 a 2025.
<i>Layout Contract</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	projekt	1	250 000,00	250 000,00	Výdavky spojené s nákupom na mieru vyvinutého a nakresleného layoutu pre špecifické čipové bloky. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B63 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárku Inflation. Výdavky sú plánované na rok 2024 a 2025.
<i>Digital P&R Layout</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	projekt	1	350 000,00	350 000,00	Digital Place and Route je fáza fyzického návrhu digitálneho integrovaného obvodu, kde sa logické prvky automaticky umiestňujú na čip a následne sa medzi nimi vytvárajú metalické prepojenia. Proces začína po syntéze RTL kódu a jeho cieľom je optimalizovať časovanie, spotrebu energie a využitie plochy. V časti "Place" sa určujú presné pozície štandardných buniek, zatiaľ čo v časti "Route" sa realizujú fyzické spoje medzi nimi. Dodržiavajú sa pritom dizajnové pravidlá a overuje sa správnosť návrhu pomocou DRC a LVS kontrol. Výsledkom je layout vo formáte GDSII, pripravený na výrobu čipu.
<i>Spolu oprávnené výdavky projektu</i>					6 455 672,90	